

平成16年11月24日

各位

会社名株式会社アルバック
代表者名代表取締役社長 中村久三
(コード番号:6728 東証一部)
問合せ先 常務取締役経営企画室長 常見佳弘
(TEL. 0467-89-2033 大代表)

次世代半導体プロセス用成膜装置「ENTRON™-EX W300 シリーズ」の販売を開始

当社は、すでに数多くの出荷実績を持つENTRON™シリーズで培ったインテグレーションマシンとしての機能を更に拡張すると共に、生産性の更なる向上を目指した様々な要素技術を搭載し、32nmノードまでの微細化プロセス対応の次世代成膜装置「ENTRON™-EX W300シリーズ」を平成17年1月より販売開始致しますので、発表致します。

1. ENTRON™-EX W300の特長

- 1) 当社従来機ENTRON™-W300/W200シリーズをベースに生産性の向上を主目的に改良を加えた最新モデルです。
- 2) 最大8プロセス(PVD, ALD, CVD, etc.)、プラス2 (Degas, Cool) モジュールを搭載できます。
- 3) 搬送システムは、当社製新型ロボットを搭載し、メカニカルスループット100wphを可能にしました。
- 4) 機能を拡張した制御ソフトウェア CyberCELL™ によって、高効率の搬送シーケンスが可能となりました。メカニカルスループットの向上にも寄与しています。
- 5) 専用プロセス又はミニファブに最適なS-type(シングルタイプ)とメガファブ対応のT-type(タンデムタイプ)を用意し、お客様の生産計画にフレキシブルに対応します。
- 6) 装置の稼働状態を監視、管理する当社製 ED-PMS⁹⁾システム(オプション)を搭載することによって、リモート診断、異常の検知・警報、予防保全、省エネ管理、装置詳細データのログ解析機能を追加する事が可能です。
- 7) 当社製インライン式非接触膜厚測定装置 MESEC™-BIT¹⁰⁾(オプション)を搭載することによって、製品ウエハの膜厚を非接触で測定し、レート管理や不良の検知、アラーム機能を追加する事が可能です。

本ニューモデルの投入により従来機以上に、FEOL¹⁾からBEOL²⁾までの様々な複合プロセスニーズに対して、より広範囲なプロセスシーケンスの選択が可能となります。また当社のオリジナル技術で微細配線用PVDのデファクトとなっているLTS³⁾、SIS⁴⁾と言った最先端のスパッタモジュールはもちろん、ALD⁵⁾やCVD等の次世代向けケミカルプロセスモジュールについても、標準搭載可能な拡張性の高い装置となっております。

搬送システムについても、当社製最新型真空搬送ロボットを搭載しており、メカニカルスループットで100wph⁶⁾以上を達成致しました。併せて、制御系ソフトウェアは従来機から採用しているCyberCELL™の拡張・改良により、搬送シーケンスの最適化を行い、プロセスニーズに理想的な搬送が可能となりました。

お客様の生産ライン構築(専用、ミニファブ、メガファブ等)に対するフレキシブルな対応を可能とするため、当社独特のラインナップとなるシングルタイプとタンデムタイプの2種類のプラットフォームを選択いただけます。またシングルタイプ⁷⁾での納入後に、タンデムタイプ⁸⁾へと仕様変更することも、容易に対応が可能です。

2. 装置名称

ENTRON™-EX W300シリーズ

(S-type;ENTRON™-EX W300S、 T-type;ENTRON™ - EX-W300T)

3. 装置価格(定価)

ENTRON™ - EX W300S/T 4.5 / 8.0億円

プロセスチャンバの構成によって異なります。

4. 販売見込み

ENTRON™-EX W300シリーズは、平成17年は15台～20台の装置販売を見込みます。今回の新機種販売開始に伴い、当社は国内外のサービスサポートを更に充実させ、これからもお客様に信頼されるパートナーとして、より一層の顧客満足を目指してまいります。

ENTRON™-EX W300は、12月1日から幕張メッセで開催されるセミコンジャパン2004に出展します。なお、平成16年8月17日に発表いたしました当社の平成17年6月期の連結業績予想に変更はありません。

5. 装置外観



以上

本件に関するお問合せ先:

(株)アルバック

半導体装置事業本部 東日本営業部 TEL:03-5218-5703

【用語の説明】

- 1) FEOL : Front End of Line/ウエハープロセスの前半部(トランジスタ形成工程)
- 2) BEOL : Back End of Line/ウエハープロセスの後半部(配線形成工程)
- 3) LTS : Long Throw Sputter
- 4) SIS : Self Ionized Sputter
- 5) ALD : Atomic Layer Deposition
- 6) 100wph : 100 Wafer Per Hour
- 7) シングルタイプ(S-type) : 搬送室が1室構成(真空搬送ロボット1式)
- 8) タンデムタイプ(T-type) : 搬送室が2室連結された構成(真空搬送ロボット2式)
- 9) ED-PMS : Electric Diagnostics Preventive Maintenance Server
- 10) MESEC-BIT : Measurement System Eddy Current Built In Type
(装置組込型非接触式薄膜測定器 Non-contact Metal Thickness Measurement System)